

第34回MES2024表彰式（第39回春季講演大会にて表彰）



MES2024 ベストペーパー賞 受賞者

◆先端プロセス・実装技術

ハイブリット接合における洗浄プロセスとCuパッドリセスの関係

小池 美夏 殿、千代蘭 修典 殿、古瀬 駿介 殿、藤井 宣年 殿、琴尾 健吾 殿、小川 直樹 殿、齋藤 卓 殿、萩本 賢哉 殿、岩元 勇人 殿（ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社）

◆最先端材料

低温Cu-Sn遷移的液相拡散接合のためのSn-Bi合金活用法の検討

黒沢 憲吾 殿（秋田県産業技術センター）、大口 健一 殿、福地 孝平 殿（秋田大学）
和合谷 繁満 殿、吉田 浩平 殿（東電化工業株式会社）

◆信頼性技術2

Siダイ / アンダーフィル界面の疲労き裂進展速度におよぼす球状シリカフィラー添加量および粒度分布の影響

田中 宏樹 殿、荻谷 義治 殿（芝浦工業大学）
榎本 利章 殿、山口 博 殿、吉田 拓弥 殿（ナミックス株式会社）

◆シミュレーション・計算機による評価・設計

放熱材中のフィラーと樹脂間のフォノン伝導による3次元熱伝達解析

荒尾 修 殿、狐塚 勝司 殿、新帯 亮 殿（株式会社デンソー）

◆めっき技術

高密着銅めっき回路形成技術のフィルムやガラス基板への応用

川上 雄介 殿（株式会社ニコン）

MES2024 研究奨励賞 受賞者

◆先端プロセス・実装技術

3D積層デバイス向けTSVのCu pumping評価

山野 友梨子 殿（ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社）

◆パワーエレクトロニクス実装技術

SiCパワーデバイスのための過渡熱抵抗測定システムの開発

福永 崇平 殿（大阪大学）

◆最先端材料

金属架橋型導電性接着剤の架橋が銅との接合強度にもたらす影響

平林 湧 殿（大阪大学）

◆信頼性技術2

Ni-P/AuめっきによるSn-Bi系合金バンプ継手特性評価

川上 夏輝 殿（大阪大学）

◆プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス

インプラント構造を用いた硬さセンサの開発とウェアラブル応用

奈良 健汰 殿（山形大学）

MES2024 ポスターアワード受賞者

◆めっき技術

ガラス上の酸化グラフェン層形成による高密着無電解銅めっき開発

中筋 渉 殿（関西大学）、郷田 隼 殿（株式会社日本触媒）、川崎 英也 殿（関西大学）

◆先端プロセス・実装技術

Au 薄膜の転写とコイニングにより作製した平坦な Au マイクロバンプアレイ

後藤 慎太郎 殿、竹内 魁 殿、日暮 栄治 殿（東北大学）

レハクホウトウ 殿、松前 貴司 殿、高木 秀樹 殿、倉島 優一 殿（産業技術総合研究所）

表彰楯

(ベストペーパー賞)



表彰楯

(研究奨励賞・ポスターアワード)



第39回春季講演大会表彰式 (第35回MES2025にて表彰)



2025年9月4日大阪大学中之島センター

第39回春季講演大会 優秀賞 受賞者

◆信頼性解析技術

高信頼性アンダーフィル材開発のための内部ひずみに着目した寿命解析手法
ナミックス株式会社 吉田拓弥 殿、榎本利章 殿

◆インテリジェント実装設計技術2

はんだ印刷工程における基板表面凸部を考慮した品質予測技術
株式会社東芝 永野里奈 殿、田辺成俊 殿、板垣達也 殿、浮田康成 殿

◆マイクロメカトロニクス実装技術3

ALD酸化アルミ薄膜の表面活性化常温接合におけるAr高速原子ビーム照射影響の調査
九州大学 宇野賢治 殿、高倉亮 殿、多喜川良 殿

◆高速高周波・電磁特性・回路技術4

機械学習を利用したトロイダル型インダクタの交流損失推定に関する一検討
東北大学 室賀翔 殿、松本駿佑 殿、児玉雄大 殿、阿加賽見 殿、遠藤恭 殿

◆光回路実装技術1

Co-Packaged Optics向け超小型106Gb/s × 8チャンネル リニアドライブVCSELトランシーバ
古河電気工業株式会社 吉田航 殿、長島和哉 殿、西崎健将 殿、米山翔 殿、那須秀行 殿

第39回春季講演大会 研究奨励賞 受賞者

◆インテリジェント実装設計技術1

機械学習を用いた建設機械査定システムの開発
群馬大学 佐々木花彩 殿

◆マイクロメカトロニクス実装技術1

マルチバイタルセンシングのためのE-スポンジの開発
東京大学 佐藤優 殿

◆低域側のカットオフ周波数のみを調整可能な広帯域チューナブルBPFの設計に関する検討

電気通信大学 松本淳一郎 殿

◆サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装2

高密度CNTフォレストによるTIM開発
静岡大学 奥村友貴 殿

◆カーエレクトロニクス実装

Ag拡散接合を用いた10 μ mピッチCuピラーの低温・低荷重・短時間接合技術
大阪大学 桂 章皓 殿

第39回春季講演大会 ポスターアワード 受賞者

◆高速伝送実装

公開データに基づいたマテリアルズ・インフォマティクスと 分子シミュレーションによる界面密着強度向上設計

株式会社日立製作所 岩崎富生 殿、坪内繁貴 殿、小野雅彦 殿、金丸昌敏 殿、青野宇紀 殿

株式会社日立ハイテク 磯部隆史 殿、木村凌太郎 殿、柘植悠太 殿、森一善 殿、青木大輔 殿

表彰楯（優秀賞）



表彰楯 (研究奨励賞・ポスターアワード賞)



受賞の皆様、おめでとうございます

更なるご活躍をお祈り申し上げます



一般社団法人 エレクトロニクス実装学会